

2025年12月10日

各 位

会 社 名 ニデック株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 岸田 光哉  
取 引 所 東証プライム (6594)  
所 在 地 京都市南区久世殿城町 338  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 渡邊 啓太  
電 話 (075) 935-6150

### 当社子会社の SEMICON Japan 2025 出展について

当社グループ会社である「ニデックアドバンステクノロジー株式会社」が、2025年12月17日(水)～12月19日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2025」に出展しますのでお知らせいたします。

各位

会社名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和  
所在地 京都府向日市森本町東ノ口1-1  
ニデックパークC棟

## 「SEMICON Japan 2025」への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2025年12月17日(水)～12月19日(金)に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2025」に出展いたします。



今回の展示会では、「One Stop Solution」をテーマに、AIサーバーやパワー半導体向けの最新ソリューションを出展いたします。パネルレベルパッケージやベースボード製品に最適な、AI技術を取り入れたAVI、2D/3D光学検査装置をはじめ、IGBT/WBGデバイス等に使用されるWafer (KGD) /Module向けの電気特性検査装置などを展示。また、熱対策を含む新たな検査ニーズに対応するプローブカード等、市場のトレンドに合わせた最先端の検査技術をご提案いたします。

### 〈出展概要〉

- ・会期：2025年12月17日(水)～12月19日(金)
- ・会場：東京ビッグサイト 東展示棟
- ・ブース：4Hall E4922
- ・公式サイト：<https://www.semiconjapan.org/jp/>

### 〈出展内容〉

- 光学式検査装置「RWi-300MK3」：2D+3D検査にAI技術を駆使
- パワー半導体向け検査装置「NATS Series」：IGBT/WBGデバイスに対応
- 高電圧対応加圧構造プローブカード：放電対策を応用
- デバイス温度測定プローブ：熱電対技術を適用
- 2D-MEMSプローブカード：2D-MEMS技術を適用し、CMOSイメージセンサーに対応
- 垂直型狭ピッチ対応プローブカード：高精度なメッキ技術で挟ピッチ55μmに対応
- プローブ「NS Probe」：MEMSプロセスを用いて微細化と特殊な形状を実現
- 自動搬送機「EFEM」：ファクトリーオートメーション対応
- 通電検査装置「GATS-8360A」：AI・LEO衛星基板向け
- 通電検査装置「GATS-7885」：PLP/Interposer向け